

证券代码：301319

证券简称：唯特偶



投资者关系活动记录表

编号：2022-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩沟通会（电话会） <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	远信基金 刘广旭 钟思怡 谢振东 黄垵锐 周伟锋 周阳；博时基金 黄继晨；平安基金 李迁；信达澳亚 陈泽昆、刘小明、朱然、吴凯；旦恩资本 向乾钰；混沌投资 杨鸿达；国投瑞银 李威；安信基金 李梓昊、尹哲；国投瑞银 董政武；国金证券 刘妍雪、丁彦文、陈良旭；宝盈基金 侯嘉敏；民生证券 刘海荣、李家豪；天风证券 许俊峰；德邦证券 许蕾；南方基金 曹群海；中庚基金 张传杰；中融基金 杨鑫桐、刘野、陈祖睿、骆尖；摩根斯丹利华鑫基金 繆东航；交银施罗德基金 田彧龙；融通基金 赵逸翔；中欧基金 邓新翱；鹏华基金 王璐。
时间	2022年11月29日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理兼董事会秘书 桑泽林 证券事务代表 廖娅伶
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司董秘桑泽林简要介绍了公司的基本情况、产品情况及行业发展情况等。 二、公司董秘桑泽林就以下问题和参与者进行了

交流

(1)公司募投项目的进展情况如何？新增产能的规划情况如何？

答：公司的募投项目，微电子焊接材料产能扩建项目、微电子焊接材料生产线技术改造项目、微电子焊接材料研发中心建设项目均在稳步推进。

未来公司将通过新增生产线，对锡膏、焊锡丝产品进行扩产。项目的实施可一方面巩固公司在下游消费电子、智能家电、LED 等领域的产品优势，另一方面为公司在汽车电子、5G 通讯、半导体封装等领域的拓展提供助力，以满足日益旺盛的市场需求。

同时公司将向产业链上游延伸，实现锡合金粉的自产。自产锡合金粉一方面可避免运输途中对锡合金粉颗粒的损伤，提升产品品质；另一方面可满足客户的多样化需求，提高生产效率、降低生产成本，增强公司竞争力。

研发中心的建设将有效提升公司新产品和新工艺的研发能力，缩短开发周期、加快研发成果的转化，丰富产品结构，提高公司对客户的响应速度，有利于巩固公司在行业中的领先地位，最终提升公司的盈利能力。

(2)是否能简要介绍一下公司半导体领域的主要应用情况？

答：唯特偶研发出多款产品适用于半导体行业的多种应用场景中：如满足大功率分立器件生产需求的高可靠性超高温高铅锡膏；满足半导体芯片封测行业焊接需求的水溶性 SAC305/SC07 合

金锡膏和水溶性超高温高铅锡膏；满足半导体芯片封测行业焊后残留清洗需求的水基清洗剂；满足半导体 IGBT 行业焊接需求的水溶性 SAC305 锡膏及常规 SAC305 合金专用锡膏；满足半导体 COB 工艺的超细粉 6 号粉、7 号粉专用锡膏。每款产品立足于各应用场景的独特的关键技术指标，通过不同的助焊膏配方体系优化，满足各种应用场景的特殊需求。

虽然半导体领域产品单位毛利高于 PCBA 类产品，但目前该领域产品业绩规模较小，对公司整体营收贡献较小。

（3）公司未来的发展规划如何？

答：公司未来发展将主要围绕“提升主业的市占率”、“积极布局新兴行业”和“开发海外市场”等三个方面，持续提升公司的营收规模和盈利能力。

提升主业的市占率。在微电子焊接材料领域，公司将继续深耕主业，顺应下游行业电子元器件小型化、轻薄化、低成本化以及工业生产日趋环保化的发展趋势，紧抓下游终端应用领域对材料性能、工艺等的需求，加大研发投入，把握核心技术，不断将产品向精细化、绿色化、低温化方向发展。并将通过生产线技术改造项目进一步降低生产运营成本，并进一步提高营收和盈利水平。

积极布局新兴行业。公司将把握行业发展机遇，积极布局 5G 通讯、光伏、新能源等新兴行业。公司将根据下游市场技术革新的需求，配套一站式的材料解决方案，并根据下游用户需求定制开发及配合工艺快速迭代，争取在新兴行业具有一

定的先发优势及工艺积累优势。未来市场前景可期，新兴行业将成为公司新的利润增长点。当前，该些领域的业绩占公司营收比例较小，敬请投资者审慎决策。

开发海外市场。公司当前的一些主要客户在东南亚、南美等区域均有生产基地，公司将会在其相应区域设立本地化的交付运营中心，满足其配套供应要求，提升公司的营收。

（4）公司目前产能是否能满足公司未来发展？

答：公司计划投资约 1.8 亿元用于微电子焊接材料产能扩建项目。公司将通过引进新装备，建设新生产线，提升公司生产规模，突破产能瓶颈。项目达产后，公司将新增锡膏年生产能力 1,270 吨，焊锡丝年生产能力 800 吨，能够有效提升公司产品供应能力，进一步满足市场需求，提升公司的市场份额和竞争力。

（5）下游行业，特别是消费电子行业疲软，是否会对公司业绩带来一定的影响？

答：公司下游应用广泛，涉及行业众多。单个行业和客户对公司的业绩影响力较小。当前，公司与下游客户的订单履行稳定，未出现有明显的订单减少情况。

（6）公司产品跟宇邦新材有无相似或重叠？

答：公司生产的微电子焊接材料作为电子材料行业的重要基础材料之一，主要应用于 PCBA 制程、精密结构件连接、半导体封装等多个产业环节的电子器件的组装与互联。光伏焊带是光伏组件的重要组成部分，应用于光伏电池片的串联或

	<p>并联；焊锡丝、焊锡条主要应用在 PCBA 的 DIP 波峰焊接和局部补充焊接。两者应用场景完全不同，生产工艺也不同，分属不同的行业</p> <p>注：接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件（如有）	
日期	2022 年 11 月 29 日